



Produktinformation

FELDER-ISO-Tin[®] „HAL-Sn100Ni + Refill“

Bleifreies Nachfülllot für HAL-Anwendung in der Leiterplattenfertigung
Sn99,93NiGe in Anlehnung an EN ISO 9453,

Art.-Nr.: 551291....

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Anwendung

Zum Nachfüllen bleifreier HAL-Verzinnungsbäder befüllt mit **FELDER-ISO-Tin[®] „HAL-Sn100Ni+“** oder auch **SN100⁴⁰³CL** bzw. **SN100CL**.

Eigenschaften

Neben den bekannten Vorzügen Ni-dotierter Lote erreicht unsere Legierung durch die Zugabe von Germanium verbesserte Benetzungseigenschaften auf Kupferoberflächen in der Leiterplattenfertigung sowie **geringste Krätzebildung** im Vergleich zu allen sonstigen bleifreien HAL-Loten. Ein besonderer Vorteil liegt in der extrem geringen Ablegerungsrate bei Kupfer (im Vergleich zu herkömmlichen SnCu-Legierungen bis zu 5-mal niedriger). Dennoch ist aufgrund der großen zu verzinnenden Kupferflächen ein Anstieg des Kupfergehaltes im Lotbad unvermeidlich. Der Einsatz des kupferfreien Nachfüllotes **HAL-Sn100Ni+ Refill** verlängert die Nutzbarkeit Ihres HAL-Lotbades merklich

Legierung	Sn99,93NiGe
Maximaler Cu-Gehalt in %	0,05
Schmelztemperatur im Lötbad bei 0,7% Cu in °C	227
Verzinnungstemperatur in °C	265 - 280
Dichte in g/cm ³	7,35
Zugfestigkeit in N/mm ²	37

Lieferformen

Ca. 400 g – Stangen, 330x20x10 mm,

Hinweise

Bleifreie FELDER-ISO-Tin[®] Elektroniklote enthalten keinerlei Stoffe, für die in der Richtlinie 2011/65/EU („RoHS II“) Beschränkungen bestehen.

Andere Legierungen sind in unserem Standardlieferprogramm enthalten.
 Bei konstantem Raumklima unbegrenzt haltbar.